

扬州扬杰电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕994号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价及申购的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,428,643股，发行价为每股人民币19.83元，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,650.00万元（其中发行费用2,500.00万元，税款150.00万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为97,350.00万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用113.21万元后，公司本次募集资金净额为97,386.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕306号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年3月31日余额	备注
------	------	--------	--------------	----

中国工商银行股份有限公司扬州分行营业部	1108020029100397802	15,000.00	-----	账户已于 2018 年度注销
中国银行股份有限公司扬州百合园支行	531369028716	26,000.00	-----	账户已于 2018 年度注销
交通银行股份有限公司扬州荷花支行	395067100018120068867	39,000.00	-----	账户已于 2018 年度注销
招商银行股份有限公司扬州开发区科技支行	514902078510202	17,386.79	-----	账户已于 2018 年度注销
合 计		97,386.79	-----	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

根据公司 2018 年 5 月 24 日第三届第十一次董事会决议，节能型功率器件芯片建设项目结项，公司将节余募集资金 11,626.24 万元永久性补充公司流动资金；根据公司 2018 年 7 月 11 日第三届第十二次董事会决议，SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目和智慧型电源芯片封装测试项目结项，公司将节余募集资金 9,783.90 万元永久性补充公司流动资金。上述三个募投项目节余资金共计 21,410.14 万元，主要原因如下：

(1) 在募投项目建设过程中，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对研发和实施环节进行优化，使得基础设施和设备投入较计划有所下降，从而在一定程度上降低了各募投项目的总支出；

(2) 公司在保证项目建设质量的前提下，始终坚持谨慎、节约的原则，对部分设备进行集中采购，并通过市场调研、询价、比价及商务谈判等多种过程控制措施，有效降低了设备的采购成本；

(3) 在募投项目建设过程中，公司严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置；持续推行降本增效项目，严控各项支出，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金；

(4)除募集资金在存放过程中产生利息收入外，在不影响项目建设进度的前提下，公司科学、合理地管理募集资金，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了较好的投资回报。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目为研发建设项目，SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目和补充流动资金项目不产生直接的经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

节能型功率器件芯片建设项目 2018 年 5 月建设完毕，产线的磨合、产能的释放及市场的开拓都需要一个周期，因此该项目产能及效益未能完全释放，导致累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金用于认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

根据公司第二届董事会第二十九次会议及 2016 年第五次临时股东大会决议，同意公司额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。根据第三届董事会第二次会议，同意公司继续使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。公司历年使用闲置募集资金购买理财产品的资金均已收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

根据公司第三届第十一次董事会决议和第三届第十二次董事会决议，公司募集资金项目均已结项，公司将节余募集资金 21,410.14 万元永久性补充公司流动资金。

公司前次募集资金不存在结余的情况。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

扬州扬杰电子科技股份有限公司

二〇二〇年六月十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：97,386.79						已累计使用募集资金总额：100,807.54 [注 1]				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：100,807.54 [注 1]				
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年：36,599.53				
						2017 年：23,555.93				
						2018 年：40,652.08[注 2]				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智慧型电源芯片封装测试项目	智慧型电源芯片封装测试项目	26,000.00	26,000.00	20,648.48	26,000.00	26,000.00	20,648.48	5,351.52	2018 年 7 月 10 日
2	节能型功率器件芯片建设项目	节能型功率器件芯片建设项目	39,000.00	39,000.00	28,989.24	39,000.00	39,000.00	28,989.24	10,010.76	2018 年 5 月 23 日
3	SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	15,000.00	15,000.00	12,360.71	15,000.00	15,000.00	12,360.71	2,639.29	2018 年 7 月 10 日
4	补充流动资金[注 2]	补充流动资金	20,000.00	17,386.79	38,809.11	20,000.00	17,386.79	38,809.11	-21,422.32	-----
合 计			100,000.00	97,386.79	100,807.54	100,000.00	97,386.79	100,807.54	-3,420.75[注 1]	

[注 1]：累计使用募集资金金额包含募集资金累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,420.75 万元。

[注 2]：根据公司第三届第十一次董事会决议和第三届第十二次董事会决议，公司募集资金项目均已结项，公司将节余募集资金 21,410.14 万元永久性补充公司流动资金。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 3 月 31 日

编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-3 月		
1	智慧型电源芯片封装测试项目	75.48% [注 1]	年利润总额 5,103.68 万元	384.16	2,148.22	4,759.05	1,692.93	8,984.36	是
2	节能型功率器件芯片建设项目	67.53% [注 1]	年利润总额 8,654.44 万元	36.47	795.93	5,886.41	1,297.79	8,016.60	否
3	SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目	----	----	----	----	----	----	----	----
4	补充流动资金	----	----	----	----	----	----	----	----

[注 1]：随着公司市场的开拓及产能的释放，2020 年 3 月智慧型电源芯片封装测试项目和节能型功率器件芯片建设项目的产能利用率分别达到 86.17%和 90.07%。